



推奨基板取付け寸法  
 PC 基板厚: 1.6±0.1  
 (非累積公差)  
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER(94V-0), COLOR: BLACK  
 CONTACT: COPPER ALLOY  
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒  
 コネクタ: 銅合金  
 リテンションレグ: 銅合金
  - めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 0.38μm MIN金めっき
  - めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 0.76μm MIN金めっき
  - めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
  - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部  
 : ニッケル下地の上に半田めっき
  - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部  
 : ニッケル下地の上にスズめっき

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J  
REV.10/83

KEYING LOCATION		KEYING	FINISH	PART NO.
		Y	△6 △4	2-316132-5
		Y	△6 △3	2-316132-3
		Y	△6 △2	2-316132-2
		X	△6 △4	1-316132-5
		X	△6 △3	1-316132-3
		X	△6 △2	1-316132-2

  

Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm²(AWG - )		mmφ		ダイナミック D-3200S 5.08 ピッチ (V) 5 極 ヘッダーアセンブリー	
MATERIAL		FINISH		DYNAMIC D-3200S 5.08PITCH(V) 5 POS.HDR CONN.ASS'Y	
SEE NOTES 注記参照		SEE NOTES 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
DR. 26/JUL/95		DE. 26/JUL/95		SIZE	LOC
K.IKEDA		K.IKEDA		A3	J
CHK. 2/AUG/95		APP. 2/AUG/95		NUMBER	
Y.ISHIKAWA		S.MANABE		C= 316132	
LTR REVISION RECORD		DR CHK DATE		SCALE	REV.
				2-1	B
				SHEET	
				1 OF 1	